



JPI催しのご案内

2026
7

公益社団法人日本包装技術協会

— 2026年度の本催しについて —

2026年度につきましても引き続きウェビナー（WEBセミナー）で
皆様に情報発信をさせていただきます。

●開催要領

日時 ①令和8年7月22日(水) 14:00～15:30
②令和8年7月23日(木) 10:30～11:30

参加費 JPI法人・個人会員：無料／一般：11,000円(1部会、税込) **定員** 300名

①令和8年7月22日(水) 14:00～15:30

JPI本部主催

【テーマ】 緩衝設計評価におけるダミー・シミュレーション活用の有効性 ～ 包装設計の効率化と評価精度向上に向けて ～

輸送包装における緩衝設計では、製品の破損を防止するために、落下試験などによる評価が広く行われています。一方で、試験時に測定される加速度の数値をどのように解釈し、設計判断へ結びつけるかについては、実務上注意が必要です。

特に、緩衝設計において用いられる「許容加速度」と、落下試験時に測定される「応答加速度」は、本来意味合いの異なる指標です。許容加速度は、製品が破損に至らないための設計上の目安であるのに対し、応答加速度は、落下時の衝撃に対して製品、ダミー、または測定部位がどのように反応したかを示す測定値です。そのため、応答加速度の数値のみをもって落下試験の可否判定を行うと、実際の破損リスクや緩衝設計の妥当性を正しく評価できない可能性があります。

本講演では、緩衝設計評価における許容加速度と応答加速度の違いを整理し、応答加速度を判定基準として扱うことの危険性について解説します。そのうえで、実製品評価、ダミー評価、シミュレーション評価をどのように使い分けるべきかを考察し、包装設計の効率化と評価精度向上に向けた実務的な視点を紹介します。

【講師】株式会社 東北ウエノ 経営企画室 取締役 室長 (包装専士)

鈴木達也氏

申込要領

- ◆お申込は当会ホームページより、先着順とさせていただきます。
- ◆お申込みが定員に達した場合、一社における参加人数に制限を持たせて頂く場合があります。
- ◆お申し込みは、JPIWEBフォーラム開催3日前までをお願いします。

個人情報の取扱いについて

- 1) 個人情報は「公益社団法人日本包装技術協会 JPIWEBフォーラム」の事業実施に関する資料等の作成、ならびに当会が主催・実施する各事業におけるサービス提供や事業のご案内等のために利用させていただきます。
- 2) 参加申込によりご提供頂いた個人情報は、法令に基づく場合等を除き、個人情報を第三者に開示、提供することはありません。

参加申し込み方法と注意事項

- ・本催しはwebを使用したオンライン講演会（ウェビナー）です。
お申し込みは、当会ホームページのJPIWEBフォーラム参加申込ページよりお願い致します。申込者にはウェビナー開催の2日前頃に招待メールをお送りします。**メールアドレスの入力を間違えてしまうと登録できずメールを送付できません**のでご注意ください。
- ・招待メールにて **参加用URL、参加方法、参加までの手順、注意事項**をお知らせしますので、ご確認の上参加の準備を進めて下さい。
※ご利用のメールアドレスの環境・設定によっては迷惑メールに振り分けられる場合がございますので、ご注意ください。
- ・申込者1名のみ本催しに参加できます。1つのメールアドレスで1名しか参加できません。
- ・その他注意事項などにつきましては当会ホームページ上よりご確認の上、参加登録をお願い致します。

当会ホームページ URL : <https://www.jpi.or.jp/>

◆お問い合わせ及び各種催しの申し込み先◆

〒104-0045 東京都中央区築地4-1-1 東劇ビル10F
公益社団法人日本包装技術協会 担当：坂本 TEL.03-3543-1189 FAX.03-3543-8970
●JPI催しのご案内はインターネットでも公開中です。 URL <https://www.jpi.or.jp/>

JAPAN PACKAGING INSTITUTE

◆裏面にもウェビナーのご案内がございます◆

② 令和8年7月23日(木) 10:30~11:30

JPI関西支部主催

【テーマ】モノマテリアルパッケージの機能性材料

環境課題への対応と資源の有効活用の必要性を背景に、モノマテリアル包装は循環型経済実現のための重要なソリューションとして注目されている。本講演では、国際的なリサイクル設計ガイドラインに基づいて開発された、酸素バリア材料、耐熱コーティング、PVCフリーインキ、脱インキ・デラミネーション技術、並びに共押出多層フィルムなど、モノマテリアル化を支える機能性材料及び技術を紹介する。これらの技術によって、包装機能を維持しながら材料構成の簡素化やCO₂排出量の削減に貢献し、社会的価値観の転換を通じて持続可能な包装の実現に寄与する。

【講師】DIC株式会社 パッケージングマテリアル技術6グループ

小林裕季氏

TOKYO INTERNATIONAL PACKAGING EXHIBITION 2026

TOKYO PACK 2026

OCT.14~16, 2026 TOKYO BIG SIGHT

包みの技術で世界に優しさを

Innovative Packaging Technology

~ The link between our future planet and generations ~

包装の最新情報が一堂に集まる国際包装展

2026東京国際包装展

2026年10/14水▶16金

東京ビッグサイト

東1-3, 7, 8ホール

開場時間 10:00▶17:00

主催 公益社団法人日本包装技術協会
JAPAN PACKAGING INSTITUTE